Patent Attorney's Docket No. <u>018976-199</u>

IN THE UNITED STAT	TES PATENT ANI	D TRADEMARK	OFFICE
--------------------	----------------	-------------	--------

In re Patent Application of)		3399
Masatoshi Arishiro, et al.) Group Art	Unit: Unassigned	2,485 1,895
Application No.: Unassigned) Examiner:	Unassigned	110
Filed: June 29, 2001)		
For: MANUFACTURING APPARATUS FOR MANUFACTURING ELECTRONIC MONOLITHIC CERAMIC COMPONENTS))))	-	#4/VDE 12/13/01

CLAIM FOR CONVENTION PRIORITY

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed:

Japan Patent Application No. 2000-231086

Filed: July 31, 2000

In support of this claim, enclosed is a certified copy of said prior foreign application. Said prior foreign application was referred to in the oath or declaration. Acknowledgment of receipt of the certified copy is requested.

Respectfully submitted,

BURNS, DOANE, SWECKER & MATHIS, L.L.P.

Date: 19 June 201

Harold R. Brown III

Registration No. 36,341

P.O. Box 1404 Alexandria, Virginia 22313-1404 (703) 836-6620

日本国特許庁 PATENT OFFICE

JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 7月31日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-231086

出 願 人 Applicant (s):

株式会社村田製作所

2001年 4月 6日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

100111

【提出日】

平成12年 7月31日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H05K 3/46

【発明者】

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

有城 政利

【発明者】

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

山口 勝巳

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

斉藤 哲朗

【特許出願人】

【識別番号】

000006231

【氏名又は名称】

株式会社村田製作所

【代表者】

村田 泰隆

【代理人】

【識別番号】

100085143

【弁理士】

【氏名又は名称】 小柴 雅昭

【電話番号】

06-6779-1498

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

040970

【納付金額】

21,000円

6

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 積層セラミック電子部品の製造装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数種類の複数枚のセラミックグリーンシートを所定の順序 で供給するシート供給部と、前記シート供給部から供給されたセラミックグリー ンシートを積層する積層部とを備える、積層セラミック電子部品の製造装置であ って、

前記シート供給部は、複数種類の複数枚のセラミックグリーンシートを種類毎 に分類して収容する複数個のトレイと、複数個の前記トレイを上下方向に整列さ せた状態でセットするラックとを備え、

各前記トレイは、前記ラックから引き出し可能であり、

前記トレイの各々には、同じ種類の複数枚のセラミックグリーンシートが積み 重ねられて収容されていて、

さらに、複数個の前記トレイを所定の順序に従って引き出すためのトレイ引出 装置と、引き出された前記トレイ内の1枚のセラミックグリーンシートを取り出 し、かつ前記積層部にまで搬送する搬送手段とを備える、積層セラミック電子部 品の製造装置。

【請求項2】 前記ラックは、上下方向に昇降可能とされ、この昇降によって所定の高さ位置にもたらされた特定の前記トレイが、前記トレイ引出装置によって引き出されるようにされる、請求項1に記載の積層セラミック電子部品の製造装置。

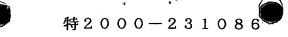
【請求項3】 前記搬送手段は、前記トレイ内の最も上のセラミックグリーンシートを吸着保持しながら移動する吸着保持装置を備える、請求項1または2に記載の積層セラミック電子部品の製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、積層セラミック電子部品の製造装置に関するもので、特に、複数 種類の複数枚のセラミックグリーンシートを所定の順序で積層することによって



得られた積層体を備える積層セラミック電子部品を製造するための装置に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】

多層セラミック基板、積層セラミックコンデンサまたは積層セラミックインダクタのような積層セラミック電子部品を製造するにあたり、複数種類の複数枚のセラミックグリーンシートを所定の順序で積層する工程が実施される。

[0003]

また、上述の積層工程において積層されるセラミックグリーンシートは、通常、その種類に応じて分類されながら、複数枚ずつ積み重ねられている、シート供給部から供給される。

[0004]

このように、シート供給部から所望の種類のセラミックグリーンシートを供給 し、この供給されたセラミックグリーンシートを所定の順序に従って積層するこ とによって、積層体を得るための装置が、たとえば特開平9-104016号公 報に記載されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述した公報に記載される装置に備えるシート供給部にあっては、複数種類のセラミックグリーンシートが種類に応じて分類されながら供給に備えるように待機されているが、複数枚のセラミックグリーンシートは、種類に応じて分類されながら、平面上に並ぶように配置されている。

[0006]

そのため、シート供給部における面積効率が低く、得ようとする積層セラミック電子部品において必要とされるセラミックグリーンシートの多様化に応じて、シート供給部を設置するのに必要な面積を大きくしてしまう。

[0007]

そこで、この発明の目的は、上述したような問題を解決し得る、積層セラミック電子部品の製造装置を提供しようとすることである。



【課題を解決するための手段】

この発明は、複数種類の複数枚のセラミックグリーンシートを所定の順序で供給するシート供給部と、このシート供給部から供給されたセラミックグリーンシートを積層する積層部とを備える、積層セラミック電子部品の製造装置に向けられるものであって、上述した技術的課題を解決するため、次のような構成を備えることを特徴としている。

[0009]

すなわち、シート供給部は、複数種類の複数枚のセラミックグリーンシートを 種類毎に分類して収容する複数個のトレイと、これら複数個のトレイを上下方向 に整列させた状態でセットするラックとを備える。各トレイは、ラックから引き 出し可能であり、トレイの各々には、同じ種類の複数枚のセラミックグリーンシ ートが積み重ねられて収容されている。

[0010]

この製造装置は、さらに、複数個のトレイを所定の順序に従って引き出すためのトレイ引出装置と、引き出されたトレイ内の1枚のセラミックグリーンシートを取り出し、かつ積層部にまで搬送する搬送手段とを備えている。

[0011]

この発明において、好ましくは、ラックは、上下方向に昇降可能とされ、この 昇降によって所定の高さ位置にもたらされた特定のトレイが、トレイ引出装置に よって引き出されるようにされる。

[0012]

また、搬送手段は、好ましくは、トレイ内の最も上のセラミックグリーンシートを吸着保持しながら移動する吸着保持装置をもって構成される。

[0013]

【発明の実施の形態】

図1は、この発明の一実施形態による積層セラミック電子部品の製造装置1に 備える主要な作業部の配置を示す平面図である。

[0014]

製造装置1は、シート供給部2、コーナーカット部3、積層部4、圧着部5およびフィルム排出部6の各作業部を備え、これらは、図1に示すように配置される。なお、これらの作業部2~6において実施される具体的な作業については、後述する。

[0015]

図2は、図1に対応する図であって、製造装置1の概略構成を示す平面図である。図3は、製造装置1の概略構成を示す正面図である。

[0016]

図1を参照しながら、図2および図3に示された要素について説明すると、シート供給部2には、ラック7が配置される。ラック7には、後述するセラミックグリーンシートを収容した複数個のトレイ8が2列に並んだ状態でセットされている。

[0017]

コーナーカット部3には、コーナーカット台9が配置される。

[0018]

積層部4には、積層台10が配置される。

[0019]

圧着部5には、圧着装置11が配置される。

[0020]

フィルム排出部6には、フィルム排出箱12が配置される。

[0021]

また、ラック7に関連して、トレイ引出装置13が配置される。

[0022]

また、セラミックグリーンシートを搬送するため、真空吸引に基づきセラミックグリーンシートを吸着保持しながら移動する第1および第2の吸着保持装置14および15が設けられる。

[0023]

積層台10は、図2および図3に示した位置と圧着装置11が設けられた位置 との間で移動可能とされ、この移動を案内するため、レール16が設けられる。

[0024]

また、トレイ引出装置13は、トレイ8を引き出すためのもので、このような引き出し動作を案内するため、レール17および18が設けられる。なお、図2および図3では、レール18に関連して設けられるトレイ引出装置13の図示が省略されている。

[0025]

第1の吸着保持装置14は、トレイ引出装置13とコーナーカット台9との間で移動可能であり、また、第2の吸着保持装置15は、コーナーカット台9と積層台10との間で移動可能であり、これらの移動を案内するため、レール19が設けられる。

[0026]

シート供給部2に配置されたラック7にセットされるトレイ8に収容されるセ ラミックグリーンシート20が図4に示されている。

[0027]

図4を参照して、たとえば厚み50μmのキャリアフィルム21が用意され、このキャリアフィルム21上にセラミックスラリーを付与することによって、セラミックグリーンシート20が成形される。このセラミックグリーンシート20の成形にあたっては、ドクターブレード法、ダイコータ法、ロールコータ法等が適用される。

[0028]

成形されるセラミックグリーンシート20の厚みは、たとえば10μm~30 0μmであり、得ようとする積層セラミック電子部品の設計に応じて、厚みの異なるものが複数種類用意される。

[0029]

また、このようにキャリアフィルム21によって裏打ちされたセラミックグリーンシート20は、図示しないが、ロール状に巻かれた状態で保管される。セラミックグリーンシート20は、ロールから引き出され、たとえば150mm×150mmの寸法となるように、切断線22に沿って、キャリアフィルム21とともに切断される。

[0030]

上述のように所定の寸法に切断されたセラミックグリーンシート20には、複数個のピン挿入穴23と複数個の基準穴24とがキャリアフィルム21をも貫通するように設けられる。これらピン挿入穴23と基準穴24とは、金型またはレーザを用いて同時に形成される。これによって、ピン挿入穴23と基準穴24との間で位置ずれが生じる余地がない。

[0031]

ピン挿入穴23は、たとえば、直径3~5 mmの大きさとされ、切断された四角形のセラミックグリーンシート20の周辺部、より詳細には、各角の部分および各辺に沿う部分に配置される。この実施形態では、ピン挿入穴23は、セラミックグリーンシート20の各辺より、たとえば3~7 mm内側の位置において、各辺に沿って5個ずつ配列されている。

[0032]

基準穴24は、たとえば、1mmの大きさとされ、切断された四角形のセラミックグリーンシート20の各辺の中央部に1個ずつ配置される。

[0033]

なお、図4を参照して説明した工程では、セラミックグリーンシートを切断した後、ピン挿入穴23および基準穴24を設けたが、図5に示すように、ロールから引き出されたセラミックグリーンシート20に、ピン挿入穴23および基準穴24を設け、その後、セラミックグリーンシート20を切断して、所定の寸法となるようにしてもよい。図5において、図4に示した要素に相当する要素には同様の参照符号を付し、重複する説明は省略する。

[0034]

図6には、所定の寸法に切断されたセラミックグリーンシート20が示されている。このようなセラミックグリーンシート20には、得ようとする積層セラミック電子部品の設計に応じて、いくつかの加工が施される。

[0035]

まず、図6に示すように、ビアホール25が形成され、ビアホール25が導電性ペースト26によって充填され、また、導電性ペーストの印刷によって所定の

パターンを有する導体膜27が形成される。ビアホール25への導電性ペースト 26の充填と導体膜27の形成とは、同時の工程で達成されても、別の工程で達 成されてもよい。

[0036]

上述したビアホール25内の導電性ペースト26および導体膜27のための導電性ペーストとしては、たとえば、銅、ニッケル、銀または銀・パラジウムを導電成分とするものが用いられる。

[0037]

ビアホール25の形成には、レーザまたは金型が適用される。

[0038]

ビアホール25への導電性ペースト26の充填にあたっては、好ましくは、ビアホール25内に負圧が及ぼされた状態で導電性ペースト26を付与することが行なわれ、この導電性ペースト26の付与は、キャリアフィルム21をマスクとして、キャリアフィルム21側から行なわれても、スクリーン印刷等を適用しながら、セラミックグリーンシート20側から行なわれてもよい。

[0039]

このようなビアホール25の形成、導電性ペースト26の充填および導体膜27の形成は、基準穴24をたとえばCCDカメラにてセンシングし、これを位置決めの基準としながら実施される。

[0040]

なお、セラミックグリーンシート20には、導体膜のみが形成されるものもあり、また、ビアホールには導電性ペーストが充填されないものもある。さらには、このような導体膜やビアホールのいずれもが形成されないものもある。

[0041]

上述のように所望の加工が施されたセラミックグリーンシート20は、その加工の種類および厚みに応じて分類され、図7および図8に示すように、トレイ8に収容され、トレイ8は、上下方向に整列されながら、ラック7にセットされる。前述したように、複数個のトレイ8が2列に並んでラック7にセットされている状態が図7によく示されている。

[0042]

ラック7は、図7に示すように、外枠28内に配置され、図示しない昇降機構によって、上下方向に昇降可能とされている。このラック7の昇降によって、特定のトレイ8が、所定の高さ位置にもたらされるように構成されている。トレイ8の各々には、同じ種類のセラミックグリーンシート20が複数枚積み重ねられて収容されている。そして、複数個のトレイ8の各々に収容されているセラミックグリーンシートを所定の順序で積層することによって、得ようとする積層セラミック電子部品のための積層体を作製することができる。

[0043]

図7に示すように、複数個のトレイ8がラック7にセットされることによって、面積効率を高めることができ、得ようとする積層セラミック電子部品において必要とされるセラミックグリーンシート20の多様化に面積を大きくすることなく対応することができる。

[0044]

なお、図示の実施形態では、複数個のトレイ8が2列に並んでラック7にセットされたが、単に1列であっても、3列以上に並んでラック7にセットされてもよい。

[0045]

必要とするセラミックグリーンシート20を取り出そうとするときには、図7において特定のトレイ8について図示されているように、必要なセラミックグリーンシート20を収容するトレイ8が、前述したトレイ引出装置13によって引き出された状態とされる。図9には、トレイ引出装置13の詳細が図示されている。

[0046]

図9を参照して、トレイ引出装置13の高さ位置に所望のトレイ8がもたらされるようにするため、ラック7が矢印29で示すように昇降される。次いで、矢印30方向に延びるレール31に沿って、チャック32が移動し、この移動の終端において、矢印33方向にチャック32が上昇し、その先端部に設けられた係合ピン34がトレイ8に係合する。次いで、チャック32が、レール31に沿っ

て逆方向へ移動することによって、トレイ8が引き出された状態とされる。

[0047]

この状態で、前述した第1の吸着保持装置14が、トレイ8内の最も上のセラミックグリーンシート20を吸着保持しながら、コーナーカット台9にまで搬送する。

[0048]

なお、第1の吸着保持装置14によって吸着保持される最も上のセラミックグリーンシート20に対して、静電気等によって、すぐ下のセラミックグリーンシート20が付着していることがあり、そのため、この下のセラミックグリーンシート20をも同時に取り出されることがある。このことを防止するため、第1の吸着保持装置14においては、次のような構成が採用されることが好ましい。

[0049]

すなわち、第1の吸着保持装置14は、セラミックグリーンシート20を、その相対向する辺の近傍で吸着保持し、これを持ち上げる瞬間に、これら吸着保持している部分を一時的に互いに近接させることによって、セラミックグリーンシート20にたるみを生じさせるように構成される。このたるみは、すぐ下のセラミックグリーンシート20を強制的に分離するように作用する。

[0050]

第1の吸着保持装置14によるセラミックグリーンシート20の取り出しを終えた後、チャック32は、レール31に沿って移動し、トレイ8をラック7内に押し戻す。そして、チャック32が、矢印33方向へ下降し、係合ピン34の係合状態を解除した後、レール31に沿って移動し、ラック7の外の位置に待機する。

[0051]

このように、第1の吸着保持装置14を待機させることにより、次のトレイ8を引き出すための動作を直ちに開始させることができ、そのため、セラミックグリーンシート20の取り出しに要する時間の短縮を図ることができる。

[0052]

また、上述のように、所望のセラミックグリーンシート20の取り出しを終え

た後、トレイ8はラック7内に戻されるので、たとえば、第1の吸着保持装置1 4による搬送経路の下方に、トレイを位置させない状態とすることができ、この ような搬送の過程で落下することのあるごみ等によって、トレイ8内のセラミッ クグリーンシート20が汚される可能性を低減することができる。

[0053]

なお、この実施形態では、キャリアフィルム21によって裏打ちされたセラミックグリーンシート20は、キャリアフィルム21を上方に向けた状態で取り扱われる。したがって、図7および図8において、トレイ8内に収容されるセラミックグリーンシート20は、キャリアフィルム21によって覆われた状態となっている。

[0054]

上述したセラミックグリーンシート20の取り出しに関して、得ようとする積層セラミック電子部品のための積層体において必要とするセラミックグリーンシート20の種類、積層順序および枚数等に関するデータは演算装置(図示せず。)に予め入力されていて、このような演算装置に基づいて、必要なセラミックグリーンシート20を収容するトレイ8が引き出され、このトレイ8からセラミックグリーンシート20が1枚ずつ第1の吸着保持装置14によって取り出されるようにされている。

[0055]

図10および図11には、図1に示したコーナーカット部3の構成が示されている。これらの図面には、図2および図3に示したコーナーカット台9が図示されている。

[0056]

コーナーカット部3においては、キャリアフィルム21によって裏打ちされた セラミックグリーンシート20の4つのコーナーをカットし、除去することが行 なわれる。その結果、4つのコーナーには、キャリアフィルム21のみが残され る。このキャリアフィルム21の4つのコーナーは、キャリアフィルム21のみ を把持することを容易にし、そのため、後述する剥離工程において、キャリアフィルム21のみを把持しながらセラミックグリーンシート20から剥離すること を容易にする。

[0057]

コーナーカット台9の上方には、押さえ板35が配置される。押さえ板35は、上下方向に移動可能とされ、その下方への移動の結果、コーナーカット台9上に搬送されたセラミックグリーンシート20をコーナーカット台9に向かって押圧する。

[0058]

また、コーナーカット台9の4つのコーナーは切り欠かれ、ここに、面取り部9aが形成され、これら面取り部9aに対向するように、カット刃36がそれぞれ配置される。カット刃36の動作は、図12に示されている。

[0059]

図12(1)に示すように、カット刃36が上昇したとき、セラミックグリーンシート20の各コーナーにおいて、キャリアフィルム21を残して、セラミックグリーンシート20のみがカットされる。

[0060]

次いで、図12(2)に示すように、カット刃36は、矢印37方向へスライド動作し、それによって、セラミックグリーンシート20のコーナー片38が除去される。その結果、キャリアフィルム21のみが4つのコーナーからはみ出た 状態が得られる。

[0061]

その後、図12(3)に示すように、カット刃36は、元の位置に戻る。

[0062]

なお、図13に示すように、カット刃36は、所定の支点を中心として、矢印39方向に回動またはスイングするように構成されてもよい。

[0063]

また、コーナーカット部3においては、コーナーカット台9上に置かれたセラミックグリーンシート20が積層されるべきものであるかがチェックされる。そのため、セラミックグリーンシート20には、その種類に応じて、予めマークが表示されている。このマークは、たとえばバーコードによって与えられる。この

特2000-231086

ようなバーコードは、たとえば、前述した導体膜27の形成のための印刷時に同時に印刷される。

[0064]

バーコードを読み取るため、コーナーカット台9の下方には、バーコードリーダ40が配置され、コーナーカット台9のバーコードが位置する部分には、窓41が設けられる。

[0065]

上述したバーコードに代えて、あるいはバーコードとともに、記号化された複数個のパンチ孔がセラミックグリーンシート20を貫通するように設けられてもよい。パンチ孔は、前述したビアホール25を形成する工程において、ビアホール25と同時に形成することができる。パンチ孔は、たとえばカメラによって読み取ることができる。

[0066]

また、この実施形態では、コーナーカット台9上に置かれたセラミックグリーンシート20の厚みがチェックされる。そのため、図11に示すように、接触式のダイヤルゲージ42がコーナーカット台9の上方に設けられる。ダイヤルゲージ42は、コーナーカット台9上のセラミックグリーンシート20、より正確には、その上のキャリアフィルム21に測定子43を接触させることによって、コーナーカット台9上のセラミックグリーンシート20の厚みを測定する。

[0067]

この厚み測定は、前述したトレイ8から第1の吸着保持装置14によって取り出され、コーナーカット台9上に置かれたセラミックグリーンシート20が、不所望にも複数枚重なっていないかどうかをチェックすることを主たる目的としている。

[0068]

なお、厚み測定は、たとえばレーザ変位計のような非接触式の測定器を用いて もよい。

[0069]

以上のようにセラミックグリーンシート20の種類に応じて表示されたバーコ

ードまたはパンチ孔が不適正であったり、厚みが不適正であったりする場合には、コーナーカット台9からセラミックグリーンシート20が取り除かれる。

[0070]

なお、バーコードまたはパンチ孔の読み取り工程とダイヤルゲージ42による 厚み測定工程とは、ほぼ同時に行なわれても、いずれか一方が先に行なわれ、い ずれか他方が後に行なわれてもよい。

[0071]

また、この実施形態では、上述したセラミックグリーンシート20の適否を判断した後に、コーナーカット台9上でのセラミックグリーンシート20のコーナーカットが実施されるが、セラミックグリーンシート20の適否を判断する工程は、コーナーカット部3以外の場所で行なわれ、適正と判断されたセラミックグリーンシート20のみがコーナーカット部3へ搬送されるようにしてもよい。

[0072]

コーナーカット動作を終えたコーナーカット台9上のセラミックグリーンシート20は、前述したように、第2の吸着保持装置15によって、積層台10上に搬送される。

[0073]

なお、第2の吸着保持装置15を省略し、コーナーカット台9上のセラミック グリーンシート20を積層台10上に搬送するため、前述した第2の吸着保持装 置14が用いられるように構成されてもよい。

[0074]

図14および図15は、それぞれ、積層台10を示す平面図および正面図である。

[0075]

積層台10は、各角の部分が切り欠かれ、そこに、面取り部10aを形成している。また、積層台10には、複数本のガイドピン44が設けられている。ガイドピン44は、セラミックグリーンシート20に設けられた前述のピン挿入穴23内に挿入されるべきものであって、ピン挿入穴23と同様の配列状態を有している。

[0076]

ガイドピン44の直径は、ピン挿入穴23の直径とほぼ同じとされ、前述したように、ピン挿入穴23の直径が3~5mmであるとき、ガイドピン44の直径も3~5mmに選ばれる。ガイドピン44の直径がピン挿入穴23の直径に比べて小さすぎると、セラミックグリーンシート20の位置合わせの精度が悪くなり、逆に、大きすぎると、ピン挿入穴23への挿入が困難になり、ピン挿入穴23の周囲においてセラミックグリーンシート20を損傷させることがある。

[0077]

ガイドピン44の先端部には、先細状のテーパが設けられることが好ましい。

[0078]

また、ガイドピン44は、積層台10に対して上下動可能に保持され、それによって、図15に示すような突出状態と図示しない非突出状態とをとり得るようにされる。

[0079]

また、積層台10上で複数枚のセラミックグリーンシート20を積層するにあたっては、図4および図5では図示しないアンダーシート45が積層台10に接するように配置されていることが好ましい。アンダーシート45は、図19および図21等に図示されている。アンダーシート45は、たとえば、表面が荒らされたプラスチックシートから構成される。

[0080]

積層台10には、アンダーシート45を固定するための手段を備えていることが好ましい。アンダーシート45は、積層台10に対して、たとえば、粘着によって保持されたり、真空吸引によって保持されたり、機械的手段によって保持されたりすることができる。

[0081]

真空吸引によって保持される場合、複数個の吸引穴が積層台10に設けられ、アンダーシート45が真空吸引に基づいて積層台10上に保持される。吸引穴の断面形状については任意に選ぶことができるが、その径は、0.4~1.0mm程度とされることが好ましい。径が0.4mmより小さいと、吸引穴を設けるた

めの加工が困難になるとともに、十分な保持力を得ることができず、他方、1.0 mmより大きいと、セラミックグリーンシート20に吸引穴の痕跡が残り、外観不良を招いたり、最悪の場合には、セラミックグリーンシート20の破損がもたらされたりすることがある。

[0082]

なお、積層台10に設けられるガイドピン44の配列は、セラミックグリーンシート20に設けられるピン挿入穴23の配列に対応して決定されるものであるが、ピン挿入穴23の配列を変更することによって、図16または図17に示すような配列をもって、ガイドピン44が積層台10に設けられることもある。

[0083]

図16では、ガイドピン44は、積層台10の各角の部分に設けられるととも に、各辺のほぼ中央部に1本ずつ設けられ、その結果、積層台10の各辺に沿っ て3本のガイドピン44が配列されている。

[0084]

図17では、ガイドピン44は、積層台10の各角の部分に設けられるととも に、各辺の中央部に片寄った位置に2本ずつ設けられ、その結果、各辺に沿って 、4本のガイドピン44が設けられている。

[0085]

これらガイドピン44の配列は、後述する圧着工程において、セラミックグリーンシート20の不所望な変形がより生じにくくするように配慮される。

[0086]

前述したように、コーナーカット部3においてコーナーカットされたセラミックグリーンシート20は、第2の吸着保持装置15によって、積層部4にまで搬送され、積層台10上のアンダーシート45上で積層される。この積層を1回終える毎に、積層台10は、レール16に沿って移動され、圧着部5に配置された圧着装置11の下方位置まで移動される。

[0087]

図18には、圧着部5に配置された圧着装置11に備える上金型46が図示されている。図18(1)は、上金型46の上面図であり、図18(2)は、上金

型46の正面図であり、積層台10を併せて示しており、図18(3)は、上金型46の下面図である。

[0088]

上金型46は、全体として、上下方向に移動するように駆動される。この上金型46の一部は、また、可動部47を構成し、この可動部47は、上金型46の 残りの部分から側方へ離れるように移動可能とされる。

[0089]

上金型46の下面側には、圧着面を与える圧着部材48が設けられる。図18 (3)によく示されているように、圧着部材48の平面形状は、積層台10の平面形状と実質的に同様であり、4つの角の部分は切り欠かれ、そこに、面取り部48aが形成されている。圧着部材48の圧着面には、積層台10から突出するガイドピン44を受け入れるための逃げ穴49が設けられている。

[0090]

また、上金型46の下面側であって、圧着部材48の4つの角の面取り部48 aのそれぞれに対向して、把持機構50および51が設けられる。これら把持機構50および51のうち、把持機構51については、可動部47上に位置されている。

[0091]

把持機構50および51は、互いに実質的に同様の構造を有していて、キャリアフィルム21のコーナーを把持するためのチャック部52を備え、このチャック部52は、キャリアフィルム21を把持および解放するため、開閉可能であり、また、圧着部材48に対して近接および離隔可能なように、キャリアフィルム21の対角線方向へ移動可能である。

[0092]

図19には、圧着装置11における上金型46に関連する動作が示されている

[0093]

まず、図19(1)には、積層台10が上金型46の下方の位置まで移動された状態が示されている。この積層台10上には、アンダーシート45が敷かれた

状態で、キャリアフィルム21によって裏打ちされた所定寸法のセラミックグリーンシート20が置かれている。セラミックグリーンシート20およびキャリアフィルム21は、ピン挿入穴23にガイドピン44を受け入れることによって、積層台10に対して位置合わせされている。また、セラミックグリーンシート20は、コーナーカット部3におけるコーナーカット工程を終えたもので、その4つのコーナーが除去されている。

[0094]

次に、図19(2)に示すように、上金型46が下降し、圧着部材48がセラミックグリーンシート20に対して圧着作用を及ぼす。このとき、把持機構50 および51の各々のチャック部52は、キャリアフィルム21のコーナーを受け入れるように移動し、次いで、閉じることによって、キャリアフィルム21のコーナーを把持する。

[0095]

次に、図19(3)に示すように、上金型46が上昇する。このとき、把持機構50および51の各々のチャック部52が、キャリアフィルム21のコーナーを把持した状態となっているので、上金型46の上昇に伴い、キャリアフィルム21がセラミックグリーンシート20から剥離される。

[0096]

次に、図19(4)に示すように、把持機構50のチャック部52が開き、キャリアフィルム21を解放する。他方、把持機構51のチャック部52は、把持 状態を維持している。

[0097]

次に、図19(5)に示すように、把持機構51のチャック部52がキャリアフィルム21を把持した状態のまま、可動部47が側方へ移動する。この移動の終端において、キャリアフィルム21は、図1ないし図3に示したフィルム排出部6に配置されたフィルム排出箱12の上方に位置される。この終端位置において、把持機構51のチャック部52が開き、キャリアフィルム21が解放され、フィルム排出箱12内へ落とされる。

[0098]

次に、積層台10は、図1に示した積層部4へと戻るように移動され、ここで 、次のセラミックグリーンシート20の積層のために待機する。

[0099]

以上説明したトレイ8からのセラミックグリーンシート20の取り出しからセラミックグリーンシート20の圧着およびキャリアフィルム21の剥離に至る各工程は、目的とする積層セラミック電子部品のための積層体が得られるまで繰り返される。

[0100]

なお、上述した圧着工程において、セラミックグリーンシート20に対して、 40~100℃の温度が付与されることが好ましい。

[0101]

また、圧着工程では、たとえば、200~350Kg/сm²の圧力が付与される。この場合、セラミックグリーンシート20に含まれるセラミック原料やバインダの種類や量、キャリアフィルム21の剥離性、セラミックグリーンシート20上に形成される導体膜27の面積、圧着されようとするセラミックグリーンシート20が何番目の積層であるか等に応じて、圧着時の圧力や時間といったセラミックグリーンシート20に及ぼされる負荷を変更するようにしてもよい。

[0102]

図20には、圧着装置の変形例が示されている。図20において、前述した図 18また図19に示した要素に相当する要素には同様の参照符号を付し、重複す る説明は省略する。

[0103]

図20に示した圧着装置11aは、前述した圧着装置11と比較して、上下逆の構成を有している。すなわち、積層台10が上金型46側に保持され、その下方に、圧着部材48ならびに把持機構50および51が配置される。

[0104]

以上説明したように、積層台10上で、積層体を得るためのセラミックグリーンシート20の必要な積層を終了したとき、この積層体53(図21または図22参照)は、アンダーシート45とともに取り出される。なお、積層体53を取

り出すとき、積層台10に設けられたガイドピン44は一旦下降し、引っ込んだ 状態とされる。これは、ガイドピン44の抵抗によって、積層体53の取り出し ミスが生じることを防止するためである。

[0105]

取り出された積層体 5 3 は、アンダーシート 4 5 を付けたまま、常温まで冷却され、その後において、図 2 1 に示すように、アンダーシート 4 5 が剥離される。これによって、積層体 5 3 の不所望な伸びや変形を防止することができる。

[0106]

次に、図22に示すように、積層体53は、そのピン挿入穴23および基準穴24が設けられていた部分を除去するため、切断線54に沿って切断される。このようにすることにより、後で実施されるプレス工程において、ピン挿入穴23および基準穴24の存在のために積層体53が不所望に伸びたり変形したりすることを防止することができる。

[0107]

次いで、積層体53は、図示しないが、凹状の下型と上ポンチとからなるプレス金型内に配置され、その状態で、たとえば剛体プレスによるプレス工程が実施され、積層体53が積層方向にプレスされる。

[0108]

なお、前述した圧着工程での圧力を上げることによって、このプレス工程を省 略することも可能である。

[0109]

次に、積層体53は、個々の積層セラミック電子部品のための積層体チップを 得るため、たとえば、ダイシングソーまたはカット刃によって切断される。

[0110]

次に、積層体チップは、焼成される。次いで、焼結後の積層体チップの外表面、たとえば端面上に、銅、銀、ニッケル等の導電成分を含む導電性ペーストが付与され、乾燥され、焼き付けることによって、外部電極が形成される。外部電極には、必要に応じて、ニッケルおよび/または錫めっきが施される。

[0111]

なお、外部電極の形成のため、焼成前の積層体チップ上に導電性ペーストを付与し、積層体チップの焼成と同時に外部電極形成のための焼付けを実施してもよい。この場合、外部電極形成のための導電性ペーストとしては、前述したビアホール25に充填された導電性ペースト26や導体膜27を形成するための導電性ペーストと実質的に同じ組成のものを用いることが好ましい。

[0112]

このようにして、所望の積層セラミック電子部品が完成される。

[0113]

【発明の効果】

以上のように、この発明によれば、積層セラミック電子部品を製造するため、セラミックグリーンシートを積層する積層部に、複数種類の複数枚のセラミックグリーンシートを所定の順序で供給するシート供給部が、複数種類の複数枚のセラミックグリーンシートを種類毎に分類して収容する複数個のトレイと、複数個のトレイを上下方向に整列させた状態でセットするラックとを備えているので、シート供給部における面積効率を高めることができ、得ようとする積層セラミック電子部品において必要とされるセラミックグリーンシートの多様化に対して、シート供給部の面積を大きくすることなく対応することができる。

[0114]

また、この発明によれば、各トレイは、ラックから引き出し可能であり、複数個のトレイを所定の順序に従って引き出すためのトレイ引出装置と、引き出されたトレイ内の1枚のセラミックグリーンシートを取り出し、かつ積層部にまで搬送する搬送手段とを備えているので、所望のセラミックグリーンシートを取り出した後は、トレイをラック内に位置させておくことができる。そのため、搬送手段によるセラミックグリーンシートの搬送時には、トレイをラック内の位置させておくことにより、この搬送の途中で落下することのあるごみ等がトレイ内のセラミックグリーンシートに付着する可能性を低減することができる。

[0115]

この発明において、ラックが、上下方向に昇降可能とされ、この昇降によって 所定の高さ位置にもたらされた特定のトレイが、トレイ引出装置によって引き出 されるようにされると、トレイ引出装置を一定の高さ位置にて動作させることができるので、トレイ引出装置およびそれに関連する構成の簡略化を図ることができる。

[0116]

この発明において、搬送手段が、トレイ内の最も上のセラミックグリーンシートを吸着保持しながら移動する吸着保持装置を備えていると、各トレイ内に収容される複数枚のセラミックグリーンシートから1枚のセラミックグリーンシートを取り出すことが容易である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明の一実施形態による積層セラミック電子部品の製造装置1に備える主要な作業部の配置を示す平面図である。

【図2】

図1に対応する図であって、製造装置1の概略構成を示す平面図である。

【図3】

図2に示した製造装置1の概略構成を示す正面図である。

【図4】

図1に示したシート供給部2において供給されるセラミックグリーンシート2 0を得るための工程を説明するための平面図である。

【図5】

セラミックグリーンシート20を得るための工程の変形例を説明するための平面図である。

【図6】

セラミックグリーンシート20にビアホール25および導体膜27を形成した 状態を示す平面図である。

【図7】

図1に示したシート供給部2に配置されるラック7の一部を示す斜視図である

【図8】

図7に示したラック7にセットされるトレイ8を単独で示す斜視図である。

【図9】

図2に示したトレイ引出装置13の動作を説明するための側面図である。

【図10】

図1に示したコーナーカット部3の構成を説明するための平面図である。

【図11】

図10に示したコーナーカット部3の正面図である。

【図12】

図10および図11に示したコーナーカット部3のコーナーカット動作を説明 するための断面図である。

【図13】

図12に示したカット刃36の動作の変形例を説明するための図である。

【図14】

図2に示した積層台10を示す平面図である。

【図15】

図14に示した積層台10の正面図である。

【図16】

積層台10の第1の変形例を示す平面図である。

【図17】

積層台10の第2の変形例を示す平面図である。

【図18】

図2に示した圧着装置11に備える上金型46を示すもので、(1)は上面図であり、(2)は正面図でありかつ併せて積層台10を示し、(3)は下面図である。

【図19】

図18に示した上金型46の動作を説明するための正面図である。

【図20】

圧着装置の変形例を示す正面図である。

【図21】

積層体53からアンダーシート45を剥離しようとする状態を示す正面図である。

【図22】

積層体53の周辺部を切断する工程を説明するための平面図である。

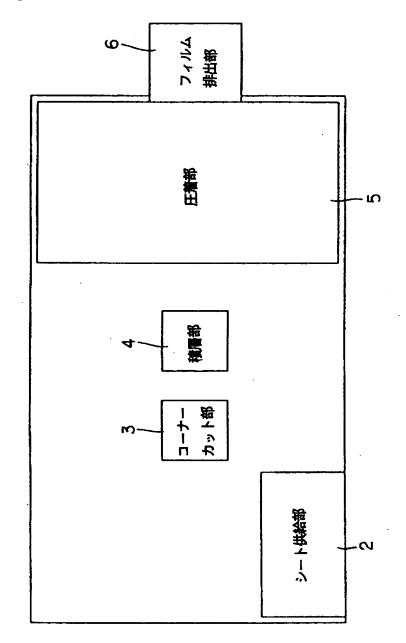
【符号の説明】

- 1 製造装置
- 2 シート供給部
- 4 積層部
- 7 ラック
- 8 トレイ
- 10 積層台
- 13 トレイ引出装置
- 14,15 吸着保持装置
- 20 セラミックグリーンシート
- 53 積層体

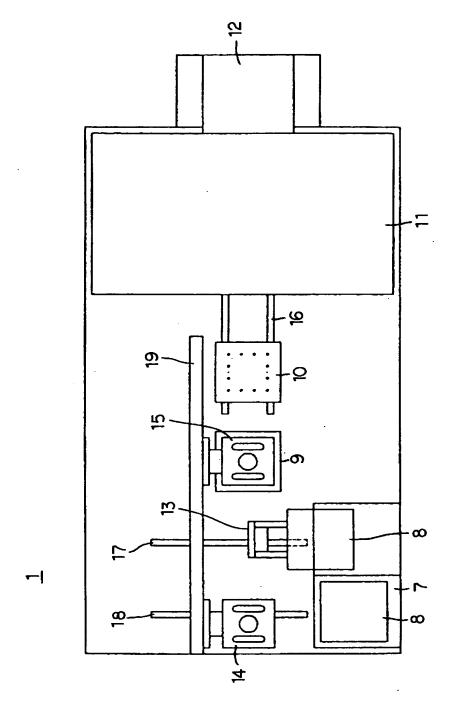


図面

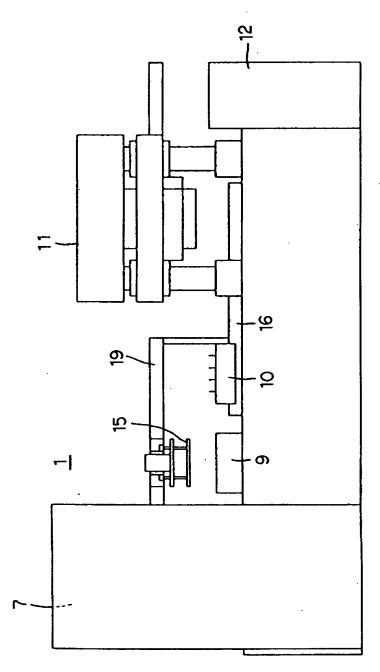
【図1】



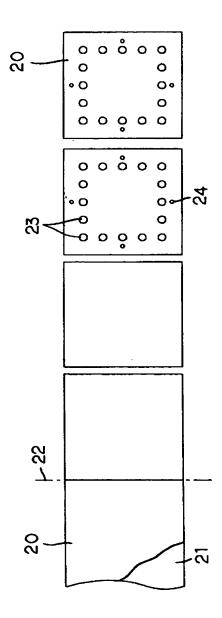
【図2】



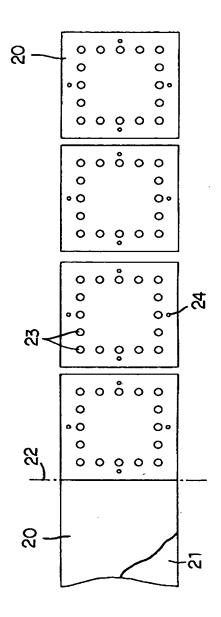
【図3】



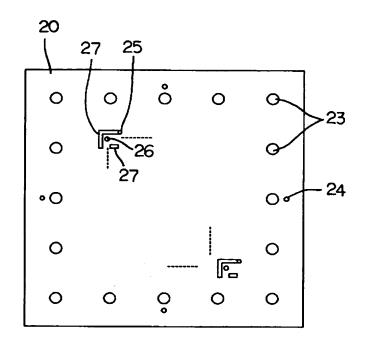
【図4】



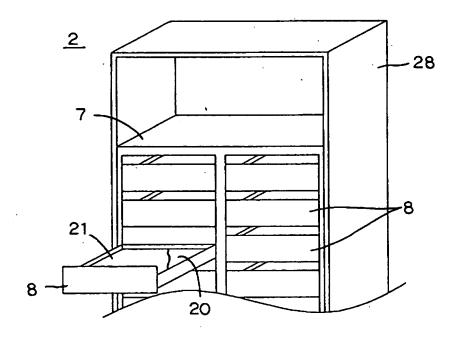
【図5】



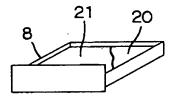
【図6】



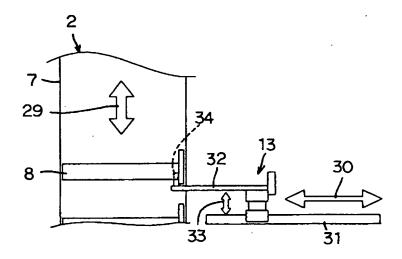
【図7】



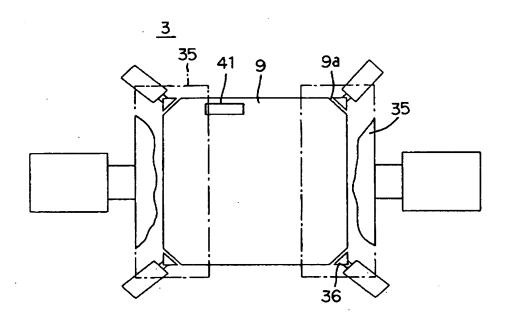
【図8】



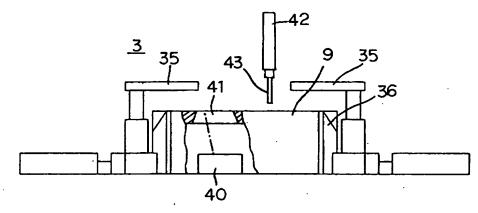
【図9】



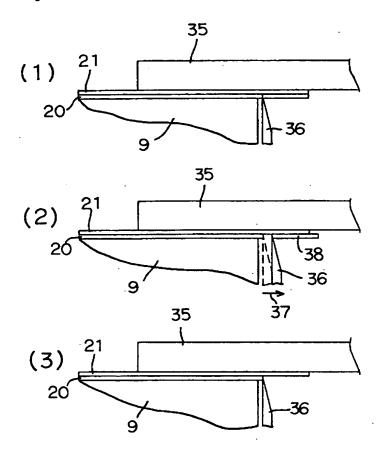
【図10】



【図11】



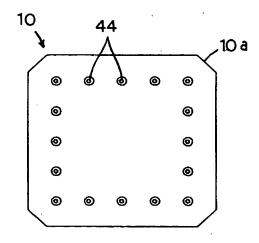
【図12】



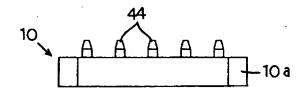
【図13】



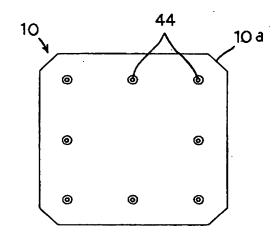
【図14】



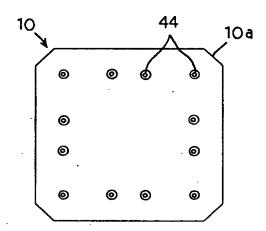
【図15】



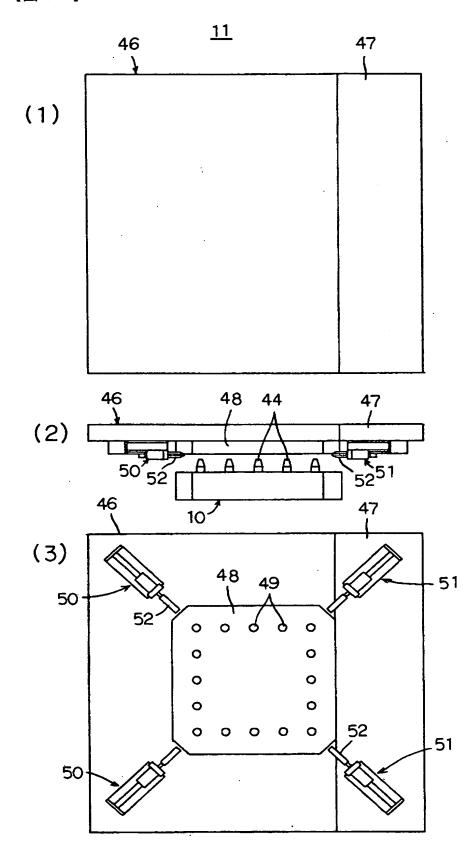
【図16】



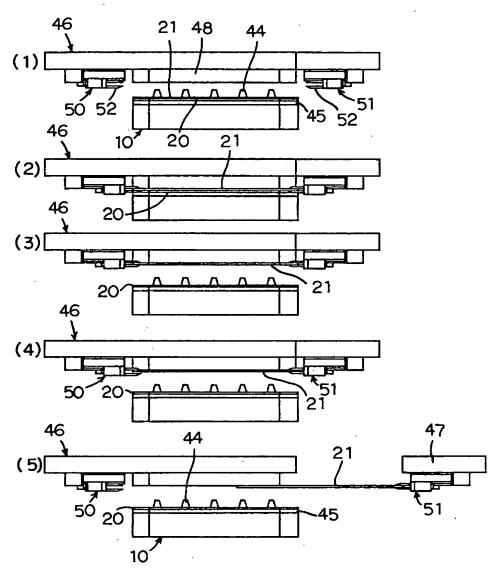
【図17】



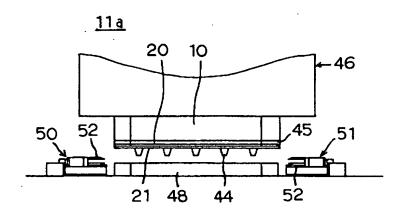
【図18】



【図19】



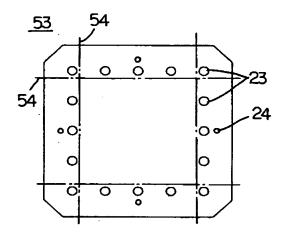
【図20】



【図21】



【図22】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 複数種類の複数枚のセラミックグリーンシートを所定の順序で供給するシート供給部と、シート供給部から供給されたセラミックグリーンシートを積層する積層部とを備える、積層セラミック電子部品の製造装置において、シート供給部の面積効率を高め得るようにする。

【解決手段】 上下方向に昇降可能とされたラック7に、上下方向に整列させた 状態で、複数個のトレイ8をセットする。各トレイ8に、同じ種類の複数枚のセ ラミックグリーンシートを積み重ねて収容する。ラック7の昇降によって所定の 高さ位置にもたらされた特定のトレイ8を、トレイ引出装置13によって引き出 し、このトレイ8内の1枚のセラミックグリーンシートを取り出し、積層部にま で搬送する。

【選択図】 図9

بع

出願人履歷情報

識別番号

[000006231]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名

株式会社村田製作所